

# 上海南芯半导体科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。

2024 年上半年，公司制定的行动方案主要进展及成效情况如下：

### 一、专注主营业务，提升经营质量

#### 1、加大研发投入，增厚研发团队成果

2024 年上半年，公司研发投入 18,267.14 万元，较上年同期增长 46.47%，研发投入总额占营业收入比例为 14.61%，截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员数量增至 440 人，较上年同期增长 32.93%。公司新增获得授权发明专利 11 项，累计获得专利 100 项，均为发明专利。

公司将持续加强技术沉淀，预计保持 2024 年研发投入占营业收入的比例不低于 15%，加大研发投入以满足公司日益增长的产品需求，并积极拓宽引进人才渠道，高效整合研发资源，优化人才队伍，为公司的规模化增长和长远发展打下坚实基础。

#### 2、丰富产品型号，积极拓展新兴应用领域

作为国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，公司围绕应用场景持续完善产品布局，为客户提供更优质的端到端完整解决方案，在多条产品领域有新品推向市场。

2024 年上半年，在汽车电子领域，公司相继推出支持多模式的车载 USB 充电芯片、车用单通道/双通道低压降稳压器、eFuse（车规级电子保险丝）等产品，部分产品已实现量产出货；在消费电子领域，从供电端到设备端，公司广泛布局

包括 AC-DC、充电协议、有线/无线充电管理、DC-DC、BMS、Display Power 等芯片产品，其中，公司继续保持有线充电管理芯片产品市场中强劲竞争力，并积极拓展有线充电以外的消费电子领域电源管理芯片全链路产品，已取得突破性进展。

未来，公司将继续以最具竞争优势的有线充电芯片产品为核心，协同发展智能手机电源及电池管理全链路芯片业务机会。此外，深度布局汽车电子和工业等领域，持续围绕客户终端应用研发新产品，不断强化竞争力。持续扩充在域控制器、智能座舱、ADAS、车身控制和 BMS 等领域的电源管理及驱动芯片布局；同时，工业自动化、AI 产业发展潜力巨大，公司正在加紧开发布局，未来有望进入工业电源、AI 领域。公司始终坚持以研发创新为长期可持续发展的“第一驱动力”，通过不断深化技术专长，强化解决方案的完整性与适配性，以此铸造公司在行业中的竞争力。

### **3、积极拓展市场，业绩稳健增长**

2024 年上半年，公司实现营业收入 125,009.58 万元，同比增长 89.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,515.38 万元，同比增长 103.86%。

2024 年下半年，公司将继续以市场需求为导向，持续密切关注终端消费者习惯变化，深刻理解终端用户对充电产品的实际需求，增强客户粘性，探索更高效、稳定的客户合作模式以及开发国内新客户，提升国内市场的市占率。通过建立海外销售渠道，积极拓展海外客户，提升业务的发展空间。

### **4、持续推进公司降本增效建设，增厚利润空间**

尽管 2024 年全球半导体市场预计有望迎来复苏，但国内芯片市场竞争剧烈的态势预计仍将持续。开展降本工作有利于减少公司开支，提升公司利润水平，提效有利于加强投入产出比，提高投入的转化效率。

2024 年上半年，公司将降本增效作为年度经营的一项重点工作，落实到相关部门和相关工作岗位进行执行，以应对全国经济疲软、竞争加剧的大环境，保持公司实现营收稳健持续增长。

### **5、制定公司长期发展战略，推进公司稳健快速成长**

2024 年上半年，公司已制定了长期的发展战略目标，并确定了未来三年短期的商业计划。2024 年公司将在智能手机、汽车电子、工业和其他消费市场共同发力，持续丰富产品品类，实现各应用场景的端到端产品布局，进一步扩大竞争优势。

2024 年下半年，公司将通过根技术开发、产品技术创新，沉淀优秀的产品定义能力，持续为客户创造价值，构建更深的业务护城河，推进公司稳步高速增长。

## 二、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

2023 年 4 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 25.40 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目”、“高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目”、“汽车电子芯片研发和产业化项目”、“测试中心建设项目”及补充流动资金等项目。目前，IPO 募集资金使用比例总体已超过 42%。

2024 上半年，公司持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。具体如下：

### 1、高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 4.57 亿元，已经投入 2.54 亿。截至 2024 年 6 月 30 日，项目投入进度达到 55.60%。2024 年，公司将持续推动项目建设，该项目基于现有电荷泵架构，研发新型充电架构，解决传统控制架构面临的效率和温升瓶颈，降低系统设计复杂度，提升系统可靠性，进一步提高超大功率充电的功率等级。面向低功耗、高精度的应用需求进行相应锂电管理芯片开发，以目前在工业及消费类应用为基础，丰富锂电管理芯片类型以适用更广泛的终端产品。基于当前的无线充电管理芯片，拓展更多无线充电模拟前端 IC 和 SoC 型 MCU，布局 Qi2 无线充电等，进一步丰富无线充电产品类别以适应各类终端产品。针对单节和多节锂电池充电应用，在公司现有的通用充电管理芯片基础上，进一步迭代、研发更高性能的充电管理芯片，提高充电精度和截止电流精度，减小待机功耗，提高对充电过程中电池电压、电流、温度等信号监测的精度，提供更高效更可靠的充电方案。通过本项目的实施，公司将进一步拓宽产品的终端应用范围，同时优化产品成本，提升产品竞争力。

### 2、高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 2.27 亿元，已经投入 0.94 亿。截至 2024 年 6 月 30 日，项目投入进度达到 41.40%。2024 年，公司将持续推动项目建设，在现有集成 GaN 直驱的控制 IC 和集成 GaN 器件的 AC-DC 产品的基础上，

进一步开发支持第三代功率半导体器件的大功率充电芯片。迭代现有 PD 和 DPDM 控制器系列产品，以支持更多快充协议，推出更多的具有快充协议控制器的 PHY 控制器和 SoC 型 MCU 产品。同时，基于 SoC 型 MCU 拓展出通用型 MCU 系列产品，丰富产品矩阵。完善现有 AC-DC 控制芯片的同时，推出 PFC 系列、软开关系列等相关系列产品，以支持更高功率等级，提高功率密度。通过本项目的实施，公司将进一步强化在开关电源领域的技术深度，保持技术先进性，拓宽产品应用领域。

### **3、汽车电子芯片研发和产业化项目**

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 3.35 亿元，已经投入 1.04 亿。截至 2024 年 6 月 30 日，项目投入进度达到 30.93%。2024 年，公司将持续推动项目建设，本项目基于现有的车载充电 IC 做进一步迭代，提高耐压和输出功率，集成更广泛的充电协议，支持更大功率车载充电，同时开发车规级 DC-DC 芯片和智能驱动芯片，支持智能配电和域控制器的应用。通过本项目的实施，公司能够对现有产品品类进行横向扩充，增强公司在电源及电池管理芯片市场的整体竞争优势。

### **4、测试中心建设项目**

该项目计划使用 IPO 募集资金投入 3.09 亿元，已经投入 0.22 亿。截至 2024 年 6 月 30 日，项目投入进度达到 7.07%。该项目通过购置各类测试分析设备，建设自有测试中心，从而帮助公司进一步降低测试成本，缩短新产品开发周期，提升产品研发到量产的转化效率，实现芯片量产前全流程的质量控制，保障高质量芯片的稳定供应。同时具备消费级，工业级和汽车级全类型产品测试分析及开发能力。2024 年下半年，公司预计将加速该项目募集资金的投入。

## **三、持续完善公司治理，筑牢高质量发展根基**

2024 年上半年，公司积极响应独立董事制度改革精神，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度进行了修订，通过进一步完善独立董事相关制度，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，强化独立董事履职保障，着力构建运作规范、决策科学的董事会。

2024 年上半年，公司已组织董监高人员积极参与证监会、上交所等监管平

台的培训课程，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

#### **四、加强投资者沟通交流，建立长期互信通道**

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证 E 互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

2024 年上半年，公司通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台共计举办 4 次投资者线上交流会，并积极参加卖方策略会、线上/线下路演、组织投资者调研接待等活动 94 次，通过接听投资者电话、E 互动平台回答投资者问题等方式持续保持市场沟通，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。

未来，公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

#### **五、注重投资者回报，共享高质量发展成果**

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，自上市以来，公司以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益，并根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

2022 年度，公司以总股本 423,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 84,706,000 元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 34.41%。

2023 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发现金红利 118,588,400 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 45.37%。

2024 年 8 月 7 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，全票审议通过

了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），截至 2024 年 7 月 31 日，公司总股本为 423,530,000 股，扣除回购专户持有股份数 302,975 股后，实际参与利润分配的股份数量为 423,227,025 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币 42,322,702.50 元（含税）。本半年度公司现金分红总额占 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润之比为 20.63%。本议案尚需提交公司股东大会审议。

未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，将密切关注监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。

## 六、强化管理层与股东的利益共担共享

2023 年 6 月，公司董事会及股东大会审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并以 2023 年 6 月 29 日为首次授予日，对共计 215 位激励对象同首次授予 870.1394 万股限制性股票。

2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，对共计 24 位激励对象预留授予 1,037,199 股限制性股票。

公司对激励计划设定了公司层面营收收入的业绩考核要求，同严密的个人层面绩效考核结合，能有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。

此外，公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基础薪资、津贴及绩效奖金组成。公司依据经营业绩及盈利状况，结合个人绩效目标完成情况进行评估，确定高管的绩效奖金。绩效奖金与公司及个人绩效挂钩。公司绩效指标包括销售额、毛利润、净利润、产品开发、客户拓展情况、投产计划、生产质量、研发项目、组织人才等，对公司经营进行全面评估。个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。2024 年下半年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

## 七、其他事宜

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案的落地。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日